

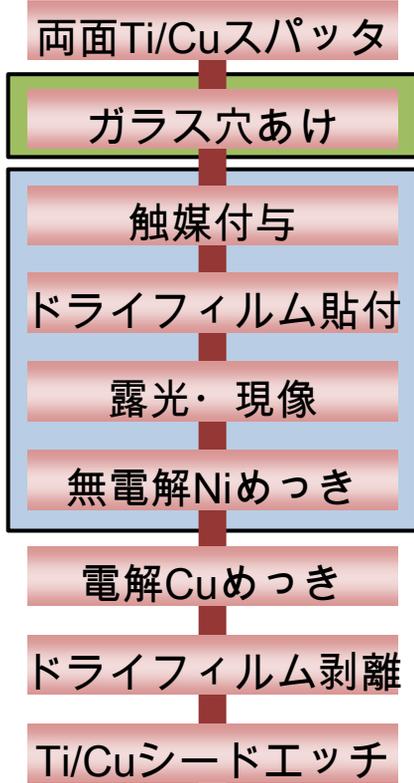
TGVプロセスの紹介

ウェットプロセスによるスルーホールめっき

【背景・目的】

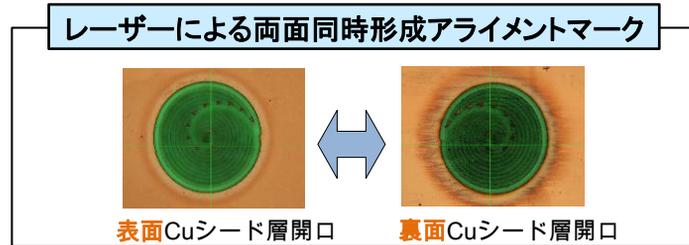
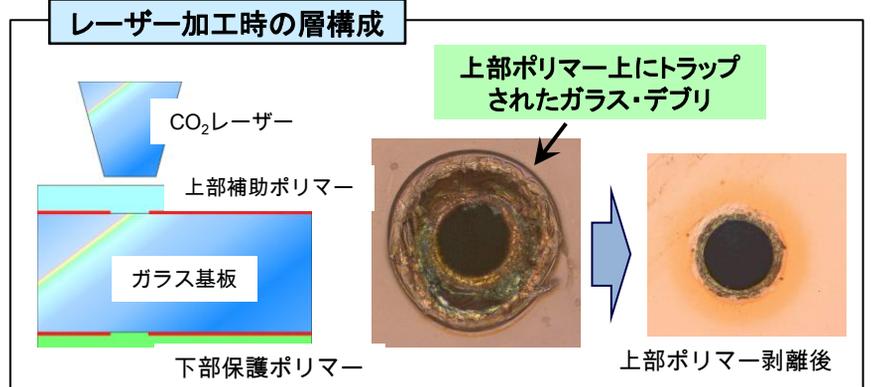
近年注目されているガラスインターポーターの要素技術であるガラス基板へのスルーホール形成および配線形成プロセスの提供

【プロセス】



【プロセスポイント①】

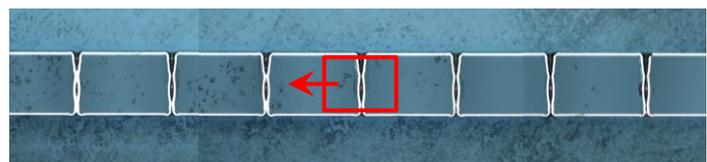
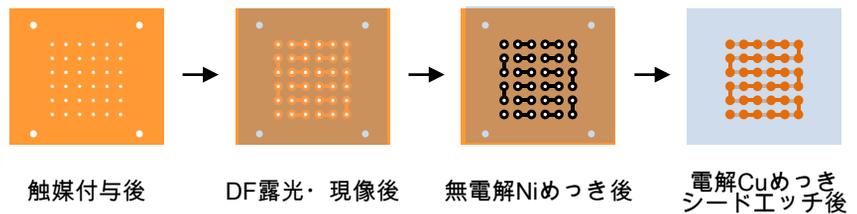
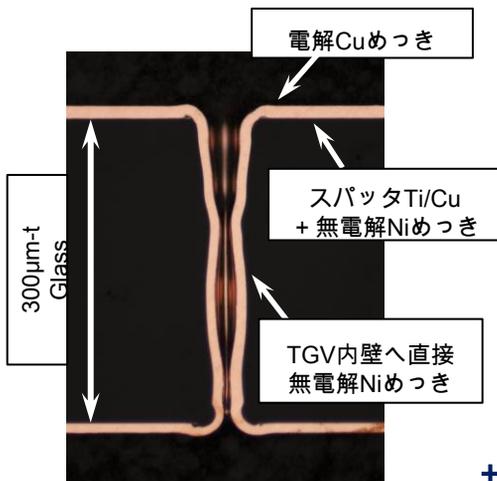
- ・ガラスの排出補助とデブリ対策
- ・両面露光用のアライメント形成手法



【プロセスポイント②】

- ・スパッタTi/Cu・ガラスへ同時に触媒付与
 - ・配線部分のスパッタ膜およびスルーホール内壁のみ無電解Niめっき析出
- ⇒無電解Niめっきのエッチング不要

【仕上がり】



サンプル設計ルール : Via pitch - 200µm, φ 60-70µm (top)

【今後の開発予定】

- ・デージーチェーンの電気特性評価
- ・ウェットプロセスによるシード層形成手法の開発